



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所

关于深圳市时创意电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书（二）

二〇二六年九月

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层

电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000

网站：www.qiyuan.com

湖南启元律师事务所

关于深圳市时创意电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书（二）

致：深圳市时创意电子股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市时创意电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市有关事项进行核查和验证，出具了《湖南启元律师事务所关于深圳市时创意电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）、《湖南启元律师事务所关于深圳市时创意电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）、《湖南启元律师事务所关于深圳市时创意电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于发行人本次发行上市申报财务报告的审计基准日由2025年12月31日调整为2026年6月30日，发行人报告期相应调整为2023年1月1日至2026年6月30日

（以下简称“报告期”），本所律师现就2025年12月31日至本补充法律意见书出具日期间（以下简称“补充事项期间”）和《补充法律意见书（一）》出具日至本补充法律意见书出具之日期间（以下简称“补充反馈期间”）发行人新增的或发生变更的重大事项补充发表法律意见，并出具《湖南启元律师事务所关于深圳市时创意电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

除本补充法律意见书另有特别说明外，本所在《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》中作出的声明及释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书为《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》之补充性文件，应与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》一起使用，如本补充法律意见书与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》内容有不一致之处，则以本补充法律意见书为准。

目 录

一、本次发行上市的批准和授权.....	4
二、发行人本次发行上市的主体资格.....	4
三、本次发行上市的实质条件.....	4
四、发行人的设立.....	8
五、发行人的独立性.....	8
六、发行人的发起人和股东（追溯至实际控制人）.....	8
七、发行人的股本及其演变.....	10
八、发行人的业务.....	10
九、关联交易及同业竞争.....	15
十、发行人的主要财产.....	26
十一、发行人的重大债权债务.....	29
十二、发行人重大资产变化及收购兼并.....	37
十三、发行人章程的制定与修改.....	37
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	38
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化.....	38
十六、发行人的税务.....	39
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	39
十八、发行人募集资金的运用.....	40
十九、发行人业务发展目标.....	40
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	41
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价.....	41
二十二、律师认为需要说明的其他问题.....	41
二十三、结论意见.....	43

正文

一、本次发行上市的批准和授权

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人 2026 年第一次临时股东会关于本次发行上市的批准与授权。

经核查，补充事项期间，上述批准与授权仍在有效期内，发行人未就本次发行上市作出新的批准与授权，也未撤销或者变更上述批准与授权。

二、发行人本次发行上市的主体资格

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人本次发行上市的主体资格情况。

根据致同出具的“致同审字（2026）第 441A034481 号”《审计报告》（以下简称“《审计报告（20260630）》”）并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的归属于母公司股东权益合计为 3,773,967,437.04 元，发行人不存在资不抵债、不能清偿到期债务或明显缺乏清偿能力的情形。

经核查，补充事项期间，发行人本次发行上市的主体资格情况未发生重大变化。

三、本次发行上市的实质条件

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《首发注册办法》《上市规则》规定的相关实质条件的具体情况。

经核查，补充事项期间，发行人本次上市的实质条件情况未发生重大变化，具体如下：

（一）本次发行上市符合《公司法》规定的相关条件

1. 根据发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司申请首次公

开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》和《招股说明书（申报稿）》，发行人本次发行的股票均为面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股发行条件和价格相同，发行价格不低于股票票面金额，任何认股人所认购股份均应当支付相同的金额，符合《公司法》第一百四十三条、第一百四十八条的规定。

2. 根据发行人 2026 年第一次临时股东会决议，发行人本次发行已经依照《公司章程》规定由股东会对发行股票的种类、数量、价格、起止日期、对象等事项作出有效决议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。

（二）本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件

1. 根据《承销及保荐协议》，发行人已聘请中信证券担任本次发行上市的保荐机构，符合《证券法》第十条第一款的规定。

2. 根据发行人组织结构图及各部门职能说明、《公司章程》及各项公司治理制度，发行人的最高权力机构为股东会，并设立了董事会、总经理、副总经理、董事会秘书、审计委员会等执行、监督及经营管理机构，发行人具备健全的组织机构，且已经对股东会、董事会等机构职权作出了明确规定。

根据发行人设立以来的历次三会会议文件，并经访谈发行人董事长、董事会秘书，发行人报告期内组织机构运行良好，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3. 根据《审计报告（20260630）》并经访谈发行人董事长、财务总监，发行人财务状况良好，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4. 致同已就发行人最近三年一期财务会计报告出具了无保留意见的《审计报告（20260630）》，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5. 根据发行人开具的守法合规证明、发行人实际控制人的无犯罪记录证明、发行人出具的书面声明等资料并经核查，发行人及其实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

6. 根据本补充法律意见书正文“三、本次发行上市的实质条件/（三）本次发行上市符合《首发注册办法》规定的相关条件”的相关内容，发行人符合《首发注册办法》规定的公开发行新股的条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

（三）本次发行上市符合《首发注册办法》规定的相关条件

1. 根据《律师工作报告》正文“二、发行人本次发行上市的主体资格”“十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作”的相关内容，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人已设立了股东会、董事会及其专门委员会等治理机构，并制定了相应的议事规则，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册办法》第十条的规定。

2. 根据《审计报告（20260630）》、发行人出具的书面声明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告，符合《首发注册办法》第十一条第一款的规定。

3. 根据致同出具的“致同审字（2026）第 441A034482 号”《内部控制审计报告》（以下简称“《内控审计报告（20260630）》”）、内控制度，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，符合《首发注册办法》第十一条第二款的规定。

4. 根据《律师工作报告》正文“十、发行人的主要财产”的相关内容，发行人资产完整；根据《律师工作报告》正文“五、发行人的独立性”的相关内容，发行人业务、资产、人员、机构、财务独立；根据《律师工作报告》正文“九、关联交易及同业竞争”的相关内容，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册办法》第十二条第（一）项的规定。

5. 根据《律师工作报告》正文“八、发行人的业务”的相关内容，发行人

最近两年内主营业务没有发生变更；根据《律师工作报告》正文“十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”的相关内容，发行人最近两年内董事、高级管理人员稳定，没有发生重大不利变化；根据《律师工作报告》正文“六、发行人的发起人和股东（追溯至实际控制人）”的相关内容，发行人最近两年内实际控制人没有发生变更，发行人实际控制人所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《首发注册办法》第十二条第（二）项的规定。

6. 根据《律师工作报告》正文“十、发行人的主要财产”“十一、发行人的重大债权债务”和“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”的相关内容，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《首发注册办法》第十二条第（三）项的规定。

7. 根据《律师工作报告》正文“八、发行人的业务”“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”的相关内容，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发注册办法》第十三条第一款的规定。

8. 根据发行人的信用报告、发行人开具的守法合规证明、发行人实际控制人的无犯罪记录证明、发行人出具的书面声明并经核查，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册办法》第十三条第二款的规定。

9. 根据发行人董事、高级管理人员出具的调查表、无犯罪记录证明并经核查，发行人董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册办法》第十三条第三款的规定。

（四）发行人符合《上市规则》规定的相关条件

1. 根据《律师工作报告》正文“三、本次发行上市的实质条件/（三）本次发行上市符合《首发注册办法》规定的相关条件”的相关内容，本次发行上市符合《首发注册办法》规定的创业板发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项之规定。

2. 发行人本次发行前股本总额为 34,838.5298 万元，不低于 3,000.00 万元；发行人本次拟发行不低于 51,614,702 股且不超过 116,128,432 股，占本次公开发行后公司总股本比例不低于 12.90%且不超过 25.00%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项、第（三）项之规定。

3. 根据《审计报告（20260630）》《预计市值分析报告》，发行人预计市值不低于 15 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第一款第（二）项之规定。

四、发行人的设立

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的设立情况。

经核查，补充事项期间，发行人的设立情况未发生变化。

五、发行人的独立性

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的独立性情况。

经核查，补充事项期间，发行人的独立性情况未发生重大变化。

六、发行人的发起人和股东（追溯至实际控制人）

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的发起人和股东情况。

（一）发行人的发起人和股东

经核查，补充事项期间，发行人的发起人和股东未发生变化，但发行人存在一名机构股东方林共创的基本情况上层合伙人发生变化，具体如下：

（12）方林共创

①基本情况

企业名称	深圳市方林共创投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MAG2A13M4H
住所	深圳市福田区福田街道福安社区民田路 171 号新华保险大厦 26 层 2601
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳汇炬共创企业管理咨询有限公司
出资总额	人民币 15,000 万元
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
成立日期	2025 年 10 月 29 日
经营期限	2025 年 10 月 29 日至无固定期限

②合伙人情况

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	王水林	14,700.0000	98.00%	有限合伙人
2	陈井阳	150.0000	1.00%	有限合伙人
3	深圳汇炬共创企业管理咨询有限公司	150.0000	1.00%	普通合伙人
合计		15,000.0000	100.00%	—

截至本补充法律意见书出具日，除上述情况外，发行人其他股东的基本情况及其上一层权益结构均未发生变化。

（二）发行人的控股股东、实际控制人

经核查，补充事项期间，发行人的控股股东、实际控制人仍为倪黄忠与李慕妃夫妇，发行人的控股股东和实际控制人未发生变更。

（三）发起人投入发行人的资产

经核查，补充事项期间，发起人投入发行人的资产的相关情况未发生变化。

（四）申报前 12 个月内新增股东核查

经核查，补充事项期间，除方林共创出资总额及上一层合伙人发生变化外，其他申报前 12 个月内新增股东的相关情况未发生变化。

（五）发行人的股东人数穿透核查情况

经核查，补充事项期间，虽发行人机构股东方林共创上一层合伙人发生变化，但经穿透确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人相关股东穿透后（追溯至自然人、国有资产监督管理机构、已备案的私募投资基金、上市公司）的人数未发生变化，仍为 39 人，未超过 200 人。

（六）发行人的股权激励

经核查，补充事项期间，发行人历次已实施的限制性股权激励情况未发生变化；补充事项期间，发行人已制定的两轮期权激励中，因离职而丧失期权激励的人数增加至 16 人。

七、发行人的股本及其演变

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的股本及演变情况。

经核查，补充事项期间，发行人的股本及演变情况未发生变化。

八、发行人的业务

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的业务。

（一）发行人的经营范围和经营方式

经核查，补充事项期间，发行人经营范围和经营方式未发生变化，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人拥有的业务经营许可资质

经核查，补充事项期间，发行人已取得的与主营业务相关的业务资质变化情况如下：

序号	持有人	证书名称/备案登记	证书/备案编号	发证机关/登记机关	有效期/发证日期
1	时创意	质量管理体系认证	CN19/30958	通标标准技术服务 有限公司	2026.05.11- 2028.01.12
2		能源管理体系认证 证书	01526En00208R0 01	杭州万泰认证有限 公司	2026.05.15- 2029.05.14

（三）发行人在中国大陆以外从事的经营活动

根据香港唐楚彦律师事务所分别就香港时创意、徽羽科技和香港赛可驰出具的专项法律意见书，香港时创意、徽羽科技和香港赛可驰在补充事项期间不存在根据当地适用法律规定的重大违法违规行为。

经核查，补充事项期间，发行人在中国大陆以外的地区从事经营活动合法、合规、真实、有效。

（四）发行人的业务变更情况

经核查，补充事项期间，发行人主营业务未发生变更。

（五）发行人的主营业务突出

根据《审计报告（20260630）》，发行人2023年、2024年、2025年、2026年1-6月的主营业务收入（合并报表口径）分别为179,990.14万元、190,031.86万元、393,965.36万元和459,380.25万元，占同期营业收入的比例分别为91.05%、85.67%、92.25%和96.63%，发行人的主要收入和利润均来自于主营业务，发行人主营业务突出。

（六）发行人的主要客户与供应商

1. 主要客户

根据《招股说明书（申报稿）》并经核查，报告期内发行人向前五名客户的销售情况如下：

单位：万元

期间	客户名称	主要产品	金额	占比
2026年 1-6月	诠鼎科技股份有限公司	嵌入式存储芯片、 存储模组	49,152.24	10.34%
	联想开天信息技术有限公司	嵌入式存储芯片、 存储模组	36,223.40	7.62%
	深圳信扬国际经贸股份有限公司	嵌入式存储芯片	31,952.01	6.72%

期间	客户名称	主要产品	金额	占比
	深圳市达迈科技信息有限公司	嵌入式存储芯片、存储模组	29,608.39	6.23%
	香港百瑞通实业有限公司	嵌入式存储芯片	26,407.80	5.55%
	合计	-	173,343.84	36.46%
2025 年	深圳市中兴康讯电子有限公司	嵌入式存储芯片	27,620.51	6.47%
	深圳市华曦达科技股份有限公司	嵌入式存储芯片	18,667.65	4.37%
	AlfaMemory Technology Co., Ltd.	存储模组、嵌入式存储芯片	18,520.60	4.34%
	深圳市华商龙商务互联科技有限公司	存储模组、嵌入式存储芯片	17,104.76	4.01%
	长城计算机	存储模组、嵌入式存储芯片	12,973.46	3.04%
	合计	-	94,886.98	22.22%
2024 年度	长城计算机	存储模组	17,861.58	8.05%
	AlfaMemory Technology Co., Ltd.	存储模组、嵌入式存储芯片	16,642.40	7.50%
	深圳市达迈科技信息有限公司	嵌入式存储芯片	10,800.62	4.87%
	深圳市领德创科技有限公司	存储模组、嵌入式存储芯片	10,661.90	4.81%
	TARGET SMART LIMITED	嵌入式存储芯片	9,568.80	4.31%
	合计	-	65,535.31	29.55%
2023 年度	AlfaMemory Technology Co., Ltd.	存储模组、嵌入式存储芯片	18,032.23	9.12%
	深圳市达迈科技信息有限公司	嵌入式存储芯片	13,866.76	7.01%
	爱国者安全科技（北京）有限公司	存储模组	13,049.71	6.60%
	ATLASLLC	存储模组、嵌入式存储芯片	8,138.95	4.12%
	立光科技有限公司	嵌入式存储芯片	8,081.87	4.09%
	合计	-	61,169.51	30.94%

注释1：对长城计算机的销售金额中包括对湖南长城计算机系统有限公司、长城国际信息技术（深圳）有限公司、中电长城科技有限公司、中国长城科技集团股份有限公司共4家同一控制下客户的销售金额。

注释2：对深圳市华商龙商务互联科技有限公司的销售金额中包括对北京北商龙科技有限公司、华商龙科技有限公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司共3家同一控制下客户的销售金额；

注释3：对立光科技有限公司的销售金额中包括对立光科技有限公司、深圳市立光电子有限公司共2家同一控制下客户的销售金额；

注释4：对深圳市达迈科技信息有限公司的销售金额中包括对深圳市达迈科技信息有限公司、深圳市达迈科技智能有限公司、先進科技（香港）有限公司、達邁國際（香港）有限公司共4家同一控制下客户的销售金额。

注释5：对深圳信扬国际经贸股份有限公司的销售金额中包括对深圳信扬国际经贸股份有限公司、信扬（香港）有限公司共2家同一控制下客户的销售金额。

注释6：对香港百瑞通实业有限公司的销售金额中包括对香港百瑞通实业有限公司、深圳市百瑞通科技有限公司共2家同一控制下客户的销售金额。

经核查，发行人、发行人的控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述主要客户不存在关联关系；不存在上述主要客户或其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

2. 主要供应商

根据《招股说明书（申报稿）》并经核查，报告期内发行人向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元

期间	供应商名称	采购内容	采购金额	占比
2026 年 1-6 月	美光	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片	307,605.95	54.29%
	长江存储科技有限责任公司	NAND Flash 晶圆及芯片	35,533.66	6.27%
	SanDisk Storage Pte. Ltd.	NAND Flash 晶圆及芯片	32,338.32	5.71%
	长沙国贸集团有限公司	NAND Flash 晶圆及芯片	21,619.81	3.82%
	科通技术	NAND Flash 晶圆及芯片	14,657.53	2.59%
	合计	-	411,755.26	72.67%
2025 年度	美光	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片	157,669.63	35.90%
	ESSENCORE Limited	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆	41,428.41	9.43%

期间	供应商名称	采购内容	采购金额	占比
		及芯片		
	长江存储科技有限责任公司	NAND Flash 晶圆及芯片	39,612.41	9.02%
	科通技术	NAND Flash 晶圆及芯片	31,058.70	7.07%
	深圳中电投资股份有限公司	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片	18,725.46	4.26%
	合计	-	288,494.61	65.69%
2024 年度	美光	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片	81,746.69	41.42%
	深圳中电投资股份有限公司	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片	31,949.42	16.19%
	STARJADE INTERNATIONAL (HK) CO LTD	NAND Flash 晶圆及芯片	10,900.89	5.52%
	EDOM TECHNOLOGY CO., LTD	主控晶圆及芯片	7,198.82	3.65%
	UNIFORTUNE (HK) COMPANY LIMITED	NAND Flash 晶圆及芯片	6,535.97	3.31%
	合计	-	138,331.79	70.10%
2023 年度	深圳中电投资股份有限公司	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片	56,589.71	25.07%
	美光	NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片	51,472.93	22.80%
	EDOM TECHNOLOGY CO., LTD	主控晶圆及芯片	15,191.91	6.73%
	长江存储科技有限责任公司	NAND Flash 晶圆及芯片	15,042.98	6.66%
	HUNG KAI STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD	NAND Flash 晶圆及芯片	12,070.50	5.35%
	合计	-	150,368.03	66.61%

注释 1：美光指 Micron Technology,Inc.及其下属子公司。

注释 2：对深圳中电投资股份有限公司的采购金额包括对 CEAC INTERNATIONAL LIMITED、CEHK INDUSTRY LIMITED、EACHAIN HONGKONG LIMITED、深圳思尔泰技术有限公司、深圳中电港技术股份有限公司共 5 家同一控制下供应商的采购金额。

注释 3：对科通技术的采购金额包括对 Comtech Digital Technology (Hong Kong) Limited、深圳市科通技术有限公司共 2 家同一控制下供应商的采购金额。

经核查，发行人、发行人的控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述主要供应商不存在关联关系；不存在上述主要供应商或其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

（七）发行人持续经营不存在法律障碍

经核查，补充事项期间，发行人不存在根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定需要终止的情形；发行人生产经营的主要资产不存在被查封、司法冻结、扣押、拍卖等被采取强制措施并影响持续经营的情形；发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

因此，发行人持续经营不存在法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人报告期内关联方、关联交易及同业竞争情况。

（一）关联方

经核查，补充事项期间，发行人关联方存在以下变化：

1. 发行人董事张凌捷新增 2 家对外担任董事的企业

序号	关联方	关联关系
1	xPower Holdings Limited	张凌捷担任该企业董事
2	芯百特微电子(无锡)有限公司	张凌捷担任该企业董事

2. 新增 1 家比照关联方披露的企业

序号	关联方	关联关系
1	Xiaomi H.K.Limited	与小米智造受同一主体控制

注释：补充事项期间，Xiaomi H.K.Limited 与发行人之间存在关联交易。考虑小米智

造报告期内曾系发行人 5%以上股东，因此按照“实质终于形式原则”将 Xiaomi H.K.Limited 比照关联方予以披露。

(二) 关联交易

根据《审计报告（20260630）》，发行人报告期内关联交易更新后的具体情况如下：

1. 关联采购与关联销售

(1) 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
深圳小米景明科技有限公司	公务用车	-	31.54	26.54	-
深圳市镓金实业有限公司	存储模组包装材料	-	-	1.46	1.90
安立创科技有限公司	嵌入式存储固件研发工作	-	-	-	840.90
序微科技有限公司	嵌入式存储固件研发工作	-	444.69	436.66	90.81

(2) 出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
酷米（香港）实业有限公司	嵌入式存储芯片及存储模组	-	298.62	2,830.82	2,364.70
深圳市酷米实业有限公司	嵌入式存储芯片及存储模组	-	255.28	730.12	2,267.06
深圳市镓金实业有限公司	嵌入式存储芯片及存储模组	-	-	1,887.59	1,747.20
深圳市意芯电子有限公司	存储模组	-	108.86	-	-
深圳市优忆芯电子有限公司	嵌入式存储芯片及存储模组	-	165.44	-	-
小米汽车科技有限公司	存储模组	-	-	-	1.31
Xiaomi H.K.Limited	嵌入式存储芯片及存储模组	4,435.36	-	-	-

2. 关联租赁

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
深圳市宝安区尚麟美喜福便利店	房屋出租	1.88	2.58	-	-

3. 关联担保

(1) 现行有效的关联担保

截至报告期末，涉及发行人正在履行的与融资相关的关联担保情况如下：

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
1	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	中国光大银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 20,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
2	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	华夏银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 10,000 万元	至债务履行期限届满之日或被担保债权的确认日（二者孰晚）起 3 年
3	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	中国民生银行股份有限公司深圳分行	最高额借款本金 10,000 万元及利息及其他应付款项之和	至债务履行期限届满之日起 3 年
4	倪黄忠、李慕妃、数钛芯			最高额借款本金 30,000 万元及利息及其他应付款项之和	至债务履行期限届满之日起 3 年
5	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	平安银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
6	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 8,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
7	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	上海银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 8,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
8	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	最高借款本金 15,000 万元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起 3 年
9	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	中信银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 40,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
10	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	兴业银行股份有限公司深圳分行	最高借款本金 43,500 万元及相关实现费用	至债务履行期限届满之日起 3 年
11	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体、时创意			最高借款本金 72,000 万元及相关实现费用	至债务履行期限届满之日起 3 年
12	倪黄忠、李慕妃、数钛芯	时创意	浙商银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 11,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
13	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、徽忆半导体	时创意	中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 12,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
14	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、徽忆半导体	时创意	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
15	倪黄忠、李慕妃、时创意	数钛芯	上海银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 1,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
16	倪黄忠、时创意、顺时投资	香港时创意	香港上海汇丰银行有限公司	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 2,000 万港币	持续性保证。其效力将持续到银行收到保证人（或其清算人、接管人、遗产代理人）发出的书面终止通知后一个日历月才会终止。
17	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、徽忆半导体	时创意	中国进出口银行深圳分行	最高借款本金 130,000 万元及相关实现费用	至债务履行期限届满之日起 3 年
18	李慕妃、倪黄忠、数钛芯	时创意	中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	借款本息及相关债权实现费用，但最高金额 12,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
19	徽忆半导体、李慕妃、倪黄忠、时创意、数钛芯	香港时创意	Sunny Sight Finance Limited	借款本息及相关债权实现费用，但最高金额 1,500 万美元	自契据生效之日起至贷款协议项下全部贷款清偿完毕或契据下权利义务全部履行完毕之日止
20	倪黄忠、李慕妃	香港时创意	小米金融（香港）有限公司	最高额借款本金 3,000 万美元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起 3 年

注释：序号 18 中，香港时创意与小米金融（香港）有限公司于 2025 年 6 月签署《贷款协议》（编号：HKSCY-DKXY-202506）约定借款额度为 3,000 万美元，报告期后额度调整至 5,000 万美元，倪黄忠、李慕妃所担保主债权金额亦同步调整。

（2）报告期内已终止的关联担保

报告期内存在但报告期末已终止或履行完毕的与融资相关的关联担保情况如下：

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
1	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体、香港时创意	时创意	中国光大银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 10,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
2	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体			借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 15,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
3	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	华夏银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 12,000 万元	至债务履行期限届满之日或被担保债权的确认日（二者孰晚）起 3 年
4				借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 10,000 万元	至债务履行期限届满之日或被担保债权的确认日（二者孰晚）起 3 年
5	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	平安银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,000 万元	至债务履行期限届满之日或展期届满之日起 3 年
6	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
7	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	上海银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 7,100 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
8	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,000 万元	至债务履行期限届满之日或展期届满之日起 3 年
9				借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,000 万元	至债务履行期限届满之日或展期届满之日起 3 年
10				借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,000 万元	至债务履行期限届满之日或展期届满之日起 3 年
11	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	中信银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 10,000 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
12	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	兴业银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 73,500 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年
13				借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 73,500 万元	至债务履行期限届满之日起 3 年

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
14				最高借款本金 36,000 万元及相关 实现费用	至债务履行期 限届满之日起 3 年
15	倪黄忠、李慕 妃、数钛芯	时创意	北京银行股份 有限公司深圳 分行	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 10,000 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
16	倪黄忠、李慕 妃、数钛芯	时创意	徽商银行股份 有限公司深圳 分行	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 2,600 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
17	倪黄忠、李慕 妃、香港时创意	时创意	交通银行股份 有限公司深圳 分行	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 3,000 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
18	倪黄忠、李慕 妃、数钛芯、徽 忆半导体	时创意	宁波银行股份 有限公司深圳 分行	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 5,000 万元	至债务履行期 限届满之日起 2 年
19	倪黄忠、李慕妃	时创意	深圳农村商业 银行股份有限 公司沙井支行	最高额借款本金 1,000 万元及相关 债权实现费用	至债务履行期 限届满之日起 3 年
20	倪黄忠、李慕 妃、倪黄英			最高额借款本金 2,900 万元及相关 债权实现费用	至债务履行期 限届满之日起 3 年
21	倪黄忠、李慕 妃、数钛芯、徽 忆半导体			最高额借款本金 4,000 万元及相关 债权实现费用	至债务履行期 限届满之日起 3 年
22	倪黄忠、李慕 妃、数钛芯、时 创意	徽忆半导体	深圳市中小企 业融资担保有 限公司	深圳市中小企业融 资担保有限公司因 履行担保责任而代 偿的款项及相关债 权实现费用	至债务履行期 限届满之日起 3 年
23	倪黄忠、李慕 妃、数钛芯、徽 忆半导体	时创意	中国农业银行 股份有限公司 深圳宝安支行	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 8,400 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
24				借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 8,400 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
25	倪黄忠	时创意	深圳前海微众 银行股份有限 公司	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 840 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
26				借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 1,000 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
27	倪黄忠、李慕 妃、数钛芯、徽 忆半导体	时创意	中国银行股份 有限公司深圳 福永支行	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 8,000 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年
28	倪黄忠、李慕 妃、香港时创 意、徽忆半导体	时创意	星展银行（中 国）有限公司 广州分行	借款本息及相关债 权实现费用, 但最 高余额 5,500 万元	至债务履行期 限届满之日起 3 年

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
29	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、微忆半导体	时创意	深圳担保集团有限公司	借款本息及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起3年
30	倪黄忠、李慕妃	时创意	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行	借款本息及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起3年
31	倪黄忠、李慕妃	香港时创意	小米金融（香港）有限公司	最高额借款本金3,000万美元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起3年
32	倪黄忠、李慕妃、时创意	香港时创意	Sunny Sight Finance Limited	最高额借款本金700万美元及相关债权实现费用	持续性保证，至主债务人全部义务被完全履行、付清并解除为止

(3) 发行人为关联方提供担保

截至本报告出具日，不存在发行人为除子公司以外的关联方提供担保的情况。

4. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	547.46	1,046.67	1,071.94	329.13

5. 关联方资金拆借

单位：万元

2026 年 1-6 月							
关联方名称	期初余额	本期拆入-本金	本期利息	本期归还-本金	本期归还-利息	汇兑损益	期末余额
-	-	-	-	-	-	-	-
2025 年度							
关联方名称	期初余额	本期拆入-本金	本期利息	本期归还-本金	本期归还-利息	汇兑损益	期末余额
顺时投资	8,838.44	-	132.05	7,892.90	1,021.64	-55.94	-
倪黄忠	6,076.78	-	65.54	5,827.82	314.50	-	-
2024 年							
关联方名称	期初余额	本期拆入-本金	本期利息	本期归还-本金	本期归还-利息	汇兑损益	期末余额

顺时投资	8,299.67	-	411.05	-	-	127.71	8,838.44
倪黄忠	7,156.97	851.00	178.73	2,037.16	72.76	-	6,076.78
2023 年							
关联方名称	期初余额	本期拆入-本金	本期利息	本期归还-本金	本期归还-利息	汇兑损益	期末余额
顺时投资	7,730.04	-	436.33	-	-	133.31	8,299.67
倪黄忠	-	9,279.17	154.30	2,265.19	11.32	-	7,156.97
王刚	-	2,000.00	14.00	2,000.00	14.00	-	-

注释 1：汇兑损益负号代表收益，以下同理。

注释 2：报告期内，发行人因日常生产经营需要存在向实际控制人倪黄忠及其控制的顺时投资拆入资金的情况，上述款项已于 2025 年 6 月底前归还完毕。

上述资金拆借的借款利率分别参考全国银行间同业拆借中心 1 年期贷款市场报价利率（LPR）、1 年期香港银行间同业拆借利率（HIBOR）计算，利率公允。

注释 3：2023 年，发行人因日常生产经营资金需要向间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东王刚借入 2,000.00 万元，并于 2023 年内归还完毕。上述资金拆借利率参考当时的全国银行间同业拆借中心 1 年期贷款市场报价利率（LPR）确定为 3.5%/年，利率公允。

6. 关联方供应链融资

报告期内，发行人与小米金融（香港）有限公司开展供应链融资合作用于采购晶圆，各期融资金额、偿还金额、融资利息情况如下：

单位：万元

年度	期初余额	本期拆入-本金	本期利息	本期归还-本金	本期归还-利息	汇兑损益	期末余额
2026 年 1-6 月	15,257.40	75,897.50	487.87	58,540.25	166.70	-690.19	32,245.63
2025 年度	3,654.73	81,921.62	1,373.04	70,208.72	1,212.47	-270.81	15,257.40
2024 年度	12,851.28	43,552.28	1,430.64	52,741.68	1,542.47	104.68	3,654.73
2023 年度	-	17,038.83	295.72	4,384.72	163.87	65.32	12,851.28

7. 关联代付

报告期内，发行人存在与关联方代付的情况，具体如下：

单位：万元

代付方	对方主体	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
时创意	倪黄忠	代扣代缴股权转让所得个人所得税	-	-	-	1,852.85
时创意	李慕妃	代扣代缴股权转让所得个人所得税	-	-	-	1,828.50
倪黄忠	时创意	代付费用	-	23.84	-	-

注释 1：发行人曾为实际控制人倪黄忠、李慕妃代扣代缴股权转让所得个人所得税。

在发行人代扣代缴时，实际控制人倪黄忠、李慕妃与发行人之间的相关代付款项均已及时结清，交易内容具有真实性及合理性。

注释 2：2025 年，发行人向数飞信息科技（江苏）有限公司采购数字人应用技术服务，由实际控制人倪黄忠代发行人支付服务费 23.84 万元，交易内容具有真实性及合理性。截至报告期末，该代付款项已结清。

8. 关联方往来款项余额

（1）应收款项

单位：万元

项目名称	关联方名称	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	酷米（香港）实业有限公司	-	-	-	-	200.11	1.11	332.68	6.32
应收账款	深圳市镓金实业有限公司	-	-	-	-	-	-	86.09	1.32
应收账款	深圳市酷米实业有限公司	-	-	-	-	-	-	40.31	0.62
应收账款	小米汽车科技有限公司	-	-	-	-	-	-	1.48	0.02
应收账款	Xiaomi H.K.Limited	4,410.06	41.90	-	-	-	-	-	-
其他应收款	深圳市宝安区	-	-	2.09	0.02	-	-	-	-

项目名称	关联方名称	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	尚麟美喜福便利店								
其他应收款	创芯二号	-	-	-	-	-	-	0.10	0.00
合计		4,410.06	41.90	2.09	0.02	200.11	1.11	460.66	8.29

注释 1：2023 年末及 2024 年末，发行人对酷米（香港）实业有限公司、深圳市镓金实业有限公司、深圳市酷米实业有限公司、小米汽车科技有限公司的应收账款系期末应收货款。

注释 2：2025 年末，发行人对深圳市宝安区尚麟美喜福便利店的其他应收款余额为 2.09 万元，系期末应收租金，发行人已于 2026 年收回该笔其他应收款。2023 年末，发行人对创芯二号的其他应收款余额为 0.1 万元，系公司预先支出的网银手续费，发行人已于 2024 年收回该笔其他应收款。

注释 3：2026 年 6 月末，公司应收 Xiaomi H.K.Limited 款项为期末应收货款 4,410.06 万元，系相关货款尚在信用期内暂未收回所致。

（2）应付款项

单位：万元

项目名称	关联方名称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他应付款	顺时投资	-	-	9,477.05	8,929.58
其他应付款	倪黄忠	-	-	6,076.78	7,156.97
其他应付款	小米金融（香港）有限公司	32,245.63	15,257.40	3,654.73	12,851.28
其他应付款	序微科技有限公司	-	-	-	54.73
应付账款	深圳市镓金实业有限公司	-	-	-	0.62
合计		32,245.63	15,257.40	19,208.56	28,993.19

注释 1：报告期内，发行人应付关联方款项主要系关联方资金拆借、关联方供应链融资、关联方提供研发服务形成。

注释 2：报告期内，发行人对实际控制人倪黄忠及其控制的顺时投资曾存在其他应付款，主要系发行人向关联方拆借资金的本金及计提利息。发行人已于 2025 年 6 月底前完成对实际控制人倪黄忠、顺时投资借款的本息偿还工作。

注释 3：报告期内，发行人对小米金融（香港）有限公司的其他应付款系关联方供应链融资本金及利息款，发行人子公司香港时创意向小米金融（香港）有限公司申请供应链融资用于采购晶圆。

注释 4：2023 年末，发行人对序微科技有限公司的其他应付款系委托研发应付款项，该款项已于 2024 年支付完毕。2023 年末，发行人对深圳市镓金实业有限公司的应付账款系应付存储模组包装材料采购款，该款项已于 2024 年支付完毕。

（三）关联交易的必要性、合理性、公允性

经核查，发行人在补充事项期间与关联方发生的关联交易系为发行人正常经营业务所需，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（四）关联交易公允决策程序和内部控制制度

经核查，发行人补充事项期间所发生的关联交易已经董事会、股东会确认，关联董事、关联股东回避了表决，独立董事发表了独立意见，关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

发行人在《公司章程》及其他有关内部制度中明确了关联交易的公允决策程序，符合有关法律、法规和有关文件的规定。

（五）减少和规范关联交易的承诺

经核查，补充事项期间，发行人控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东已出具的减少和规范关联交易的承诺未发生变化。

（六）同业竞争

经核查，补充事项期间，发行人与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。发行人的控股股东、实际控制人已出具的避免同业竞争的承诺未发生变化。

（七）关联交易与同业竞争的披露

发行人已在《招股说明书（申报稿）》充分披露了发行人对有关关联交易及解决同业竞争的承诺或措施，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的主要财产。

（一）不动产权

经核查，补充事项期间，发行人及其子公司拥有的不动产权未发生变化。

（二）租赁房屋

经核查，补充事项期间，发行人及其子公司、分公司正在履行的房屋租赁情况存在以下更新：

序号	出租人	承租人	坐落	面积	用途	租赁期限
1	北京佳隆房地产开发集团有限公司	合肥时创意北京分公司	北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦11层1101单元及1102单元	379.84 m ²	办公	2023.6.16-2028.09.15

（三）在建工程

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人不存在正在建设过程中的工程项目。

（四）商标权

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共拥有 24 项中国注册商标，18 项境外注册商标，详见本补充法律意见书正文之“附件一、发行人及其控股子公司的注册商标”。

根据发行人出具的书面声明并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的中国境内注册商标不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

根据深圳知知鸟知识产权服务有限公司于 2026 年 7 月 16 日出具的《关于深圳市时创意电子股份有限公司之境外商标核查意见》、深圳市永正知识产权代理有限公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《境外商标查询证明书》、江苏西科知识产权代理有限公司于 2026 年 7 月 20 日出具的《境外商标查询证明书》、发行

人出具的书面声明，发行人及其子公司拥有的中国境外注册商标无任何撤销、异议、失效的情形，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（五）专利权

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共计拥有 194 项境内专利（包括发明专利 18 项（含共有发明专利 1 项）、实用新型专利 159 项（含共有实用新型专利 1 项）、外观设计专利 17 项）、2 项共有境外发明专利，详见本补充法律意见书正文之“附件二、发行人及其控股子公司的专利权”。

根据发行人出具的书面声明并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有的专利不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

根据深圳市百瑞专利商标事务所（普通合伙）于 2026 年 9 月 16 日出具的《专利查询证明书》、发行人出具的书面声明，发行人拥有的境外专利均处于有效期内，专利年费已及时支付，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（六）著作权

1. 计算机软件著作权

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已取得计算机软件著作权登记证书共计 12 项，详见本补充法律意见书正文之“附件三、发行人及其控股子公司的计算机软件著作权”。

根据发行人出具的书面声明并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

2. 作品著作权

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已取得作品著作权登记证书共计 2 项，详见本补充法律意见书正文之“附件四、发行人及其控股子公司的作品著作权”。

根据发行人出具的书面声明并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的作品著作权不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到

限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（七）域名

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人共拥有 2 项境内域名，具体情况如下：

序号	注册所有人	网站域名	审核通过日期	ICP 备案号
1	时创意	shichuangyi.com	2024.04.02	粤 ICP 备 16006736 号-1
2	时创意	shichuangyi.cn	2021.12.30	粤 ICP 备 16006736 号-2

根据发行人出具的书面声明并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的境内域名不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（八）主要生产经营设备

根据《审计报告（20260630）》并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人固定资产账面价值为 67,624.31 万元，具体如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	38,295.76	1,810.20	-	36,485.56
机器设备	41,630.98	12,379.06	-	29,251.91
运输设备	198.42	147.50	-	50.92
办公设备	454.04	379.67	-	74.37
其他设备	2,078.86	317.32	-	1,761.54
合计	82,658.06	15,033.75	-	67,624.31

根据发行人出具的书面声明并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人拥有的主要生产经营设备不存在抵押、质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（九）股权投资

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人拥有境内外子公司、分公司的情况未发生变化。

(十) 主要财产的权利限制情况

经核查，补充事项期间，发行人主要财产的权利限制情况未发生变化。

十一、发行人的重大债权债务

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的重大债权债务。

(一) 重大合同

经核查，补充事项期间，发行人生产经营情况及采购、销售模式未发生重大变化，重大合同标准未发生变化。

有鉴于此，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人重大合同情况更新如下：

1. 重大销售合同

序号	客户名称	合同类型	合同标的	合同期限/ 签署日期	合同金额	履行情况
1	AlfaMemory Technology Co., Ltd.	框架合同	嵌入式存储芯片 产品	2023.01.01- 2024.01.01	以订单为准	履行完毕
2		框架合同	嵌入式产品；模 组类产品	2024.01.01- 2024.12.31	以订单为准	履行完毕
3		框架合同	模组类产品	2025.01.01- 2025.12.31	以订单为准	履行完毕
4	深圳市达迈科 技信息有限公 司	框架合同	嵌入式存储芯 片、模组类产品	2023.09.21- 2024.01.01	以订单为准	履行完毕
5		框架合同	嵌入式存储芯 片、模组类产品	2024.01.01- 2024.12.31	以订单为准	履行完毕
6	ATLASLLC	框架合同	SSD, RAM, External SSDs, USB flash drives,eMMC, Micro-SD 等	2023.09.21- 2025.12.31 (合作期限 届满前 1 个 月内，未提 出书面异议 的，合作期 限自动延展 1 年，以此 类推)	以订单为准	履行完毕
7	立光科技有 限公司、深圳立 光电子有限公 司	框架合同	嵌入式存储芯片	2023.01.01- 2023.12.31	以订单为准	履行完毕
8	湖南长城计 算机系统有限公	框架合同	固态硬盘/内存 条	2023.06.14- 2024.06.15	以订单为准	履行完毕

序号	客户名称	合同类型	合同标的	合同期限/ 签署日期	合同金额	履行情况
9	司	框架合同	固态硬盘/内存条	2024.06.16-2027.06.15	以订单为准	履行中
10		框架合同	固态硬盘/内存条	2024.05.30-2026.05.30	以订单为准	履行完毕
11	深圳市领德创科技有限公司	框架合同	存储类产品 (SSD、内存条、eMMC、TF卡)	2024.11.08-2025.11.07 (期满双方无书面异议, 自动展期1年)	以订单为准	履行中
12	深圳市中兴康讯电子有限公司	订单	eMMC	2025.03.26	4,800,000 (美元)	履行完毕
13	深圳市华曦达科技股份有限公司	订单	eMMC	2025.06.27	3,400,000 (美元)	履行完毕
14	华商龙科技有限公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司、北京北商龙科技有限公司	框架合同	嵌入式产品	2025.01.01-2025.12.31	以订单为准	履行完毕
15	联想开天信息技术有限公司	框架合同	内存	2025.05.16至今	以订单为准	履行中
16	联想智慧科技(天津)有限公司	框架合同	内存、固态硬盘	2025.08.02至今	以订单为准	履行中
17	深圳市达迈科技智能有限公司、深圳市达迈科技信息有限公司、达迈国际(香港)有限公司、达迈科技智能(香港)有限公司	框架合同	嵌入式、模组类产品	2026.01.01-2026.12.31	以订单为准	履行中
18	深圳市百瑞通科技有限公司、香港百瑞通实业有限公司	框架合同	嵌入式产品	2026.01.01-2026.12.31	以订单为准	履行中
19	诠鼎科技股份有限公司	框架合同	嵌入式、模组类产品	2026.01.01-2026.12.31	以订单为准	履行中
20	XINYANG(HONGKONG)CO.,LIMITED	订单	存储 IC	2026.01.22	21,425,840 (美元)	履行完毕
21		订单	存储 IC	2026.01.15	4,500,000 (美元)	履行完毕

序号	客户名称	合同类型	合同标的	合同期限/ 签署日期	合同金额	履行情况
22	信扬(香港)有限公司	订单	存储 IC	2026.06.04	38,865,640 (美元)	履行中
23		订单	存储 IC	2026.06.05	5,000,000 (美元)	履行中

注释 1：序号 8、9 的框架合同签署主体系发行人，序号 10 的框架合同签署主体系香港时创意。

注释 2：序号 22、23 的订单截至 2026 年 6 月 30 日尚未交货。

2. 重大采购合同

序号	供应商名称	合同类型	合同标的	合同期限/ 签署日期	合同金额	履行情况
1	深圳中电投资有限公司	框架合同	晶圆等货物	2023.06.28- 2026.06.30	以订单为准	履行中
2	Micron Semiconductor Asia Operations Pte. Ltd.	订单	晶圆	2025.12.11	9,899,571 (美元)	履行完毕
3		订单	晶圆	2025.12.12	10,495,450 (美元)	履行完毕
4	长江存储科技有限责任公司	框架合同	闪存产品	2023.01.01- 2023.12.31	以订单为准	履行完毕
5		框架合同及其补充协议	晶圆或颗粒形式的 3DNAND 闪存芯片及相关服务	2024.03.18- 2027.03.18	以订单为准	履行中
6	Comtech Digital Technology(Hong Kong)Limited	订单	NAND Wafer、NAND Die	2025.12.16	6,971,969.31 (美元)	履行完毕
7	ESSENCORE LIMITED	框架合同	OQ 产品	2025.11.01- 2026.10.31	以订单为准	履行中
8		框架合同	NAND 产品	2025.10.25- 2026.10.24	以订单为准	履行中
9	SanDisk Storage Pte.Ltd.	订单	NAND Wafer、NAND Die	2026.03.12	20,032,814.10 (美元)	履行完毕
10		订单	NAND Wafer、NAND Die	2026.03.12	19,966,393.20 (美元)	履行完毕
11	Micron Semiconductor AsiaOperations Pte.Ltd.	订单	晶圆	2026.01.05	7,399,556.00 (美元)	履行完毕
12		订单	晶圆	2026.01.13	8,395,464.00 (美元)	履行完毕
13		订单	晶圆	2026.05.13	16,139,885.00 (美元)	履行完毕
14		订单	晶圆	2026.05.20	6,041,150.00 (美元)	履行完毕
15		订单	晶圆	2026.05.27	8,679,671.00 (美元)	履行完毕

序号	供应商名称	合同类型	合同标的	合同期限/ 签署日期	合同金额	履行情况
16		订单	晶圆	2026.06.15	6,599,983.50 (美元)	履行完毕
17		订单	晶圆	2026.06.16	8,922,072.00 (美元)	履行完毕
18		订单	晶圆	2026.06.21	6,671,217.50 (美元)	履行完毕
19		订单	晶圆	2026.06.22	15,832,610.5 0 (美元)	履行完毕
20		订单	晶圆	2026.06.25	6,723,172.50 (美元)	履行完毕
21	科通國際(香港) 有限公司 /Comtech International(Hong Kong)Limited	框架合同	晶圆	2025.02.18- 2027.02.17	以订单为准	履行中

3. 授信合同、借款合同与担保合同

单位：万元

授信/ 借款 银行	被授 信人/ 借 款 人	授信合同编 号	借款合同编号	授信/借款 期限	授信/ 借款 额度	担保人/ 抵押物/ 质押物	担保合同
中国光大银行股份有限公司深圳分行	时创意	《综合授信协议》（编号：ZH3918251100303）	/	2025.11.07- 2027.05.06	20,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导体	《最高额保证合同》（编号：GB39182511003-1）； 《最高额保证合同》（编号：GB39182511003-2）； 《最高额保证合同》（编号：GB39182511003-3）； 《最高额保证合同》（编号：GB39182511003-4）
			《流动资金贷款合同》（编号：ZH39182511003-1jk）	2025.11.07- 2026.11.06	5,000		
			《流动资金贷款合同》（编号：ZH39182511003-2jk）	2025.11.13- 2026.10.27	5,000		
			《流动资金贷款合同》（编号：ZH39182511003-3JK）	2026.01.27- 2027.01.26	5,000		
中国民生银行股份有限公司深圳分行	时创意	《综合授信合同》（编号：公授信变字第前海 2503 号）	/	2025.01.16- 2026.01.16	10,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导体	《最高额保证合同》（编号：公高保字第前海 2503-1 号）； 《最高额保证合同》（编号：公高保字第前海 2503-2 号）； 《最高额保证合同》（编号：公高保字第前海 2503-3 号）； 《最高额保证合同》（编号：公高保字第前海 2503-4 号）
			《流动资金贷款借款合同》（编号：公流贷字第 ZX25110001792 650 号）	2025.11.25- 2026.07.16	6,000		
		《综合授信合	/	2026.03.03- 2027.03.03	30,000	倪黄忠、	《最高额保证合同》（编

授信/ 借款 银行	被授 信人/ 借款 人	授信合同编 号	借款合同编号	授信/借款 期限	授信/ 借款 额度	担保人/ 抵押物/ 质押物	担保合同
		同》（编号： 公授信字第前 海 2605 号）	《流动资金贷款 借款合同》（编 号：公流贷字第 ZX26030002016 216 号）	2026.03.13- 2026.08.13	10,000	李慕妃、 数钛芯	号：公高保字第前海 2605-1 号）； 《最高额保证合同》（编 号：公高保字第前海 2605-2 号）； 《最高额保证合同》（编 号：公高保字第前海 2605-3 号）
			《流动资金贷款 借款合同》（编 号：公流贷字第 ZX26040002078 000 号）	2026.04.15- 2026.11.20	4,000		
			《流动资金贷款 借款合同》（编 号：公流贷字第 ZX26030002003 221 号）	2026.03.06- 2027.03.06	10,000		
平安银 行股份 有限公 司深圳 分行	时创意	《综合授信额 度合同》（编 号：平银深圳 公八综字 20250825 第 001 号）	/	/	5,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导 体	《最高额保证合同》（编 号：平银深圳公八额保字 20250825 第 004 号）； 《最高额保证合同》（编 号：平银深圳公八额保字 20250825 第 003 号）； 《最高额保证合同》（编 号：平银深圳公八额保字 20250825 第 002 号）； 《最高额保证合同》（编 号：平银深圳公八额保字 20250825 第 001 号）
		/	《贷款合同》 （编号：平银深 圳公八贷字 20250825 第 001 号）	2025.09.08- 2026.09.08	5,000		
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司深 圳分行	时创意	《融资额度协 议》（编号： BC202511110 0001248）	/	2025.11.25- 2026.11.11	8,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导 体	《最高额保证合同》（编 号： ZB7937202500000094）； 《最高额保证合同》（编 号： ZB7937202500000095）； 《最高额保证合同》（编 号： ZB7937202500000096）
		/	《流动资金贷款 合同》（编号： 79372025280496 ）	2025.12.11- 2026.12.11	6,000		
上海银 行股份 有限公 司深圳 分行	时创意	《综合产品池 业务合同》 （编号： HTWB440100 016202500013 8）	/	2025.09.29- 2026.09.28	8,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导 体	《最高额保证合同》（编 号： HTWB44010001620250001 39）； 《最高额保证合同》（编 号： HTWB44010001620250001 40）； 《最高额保证合同》（编 号： HTWB44010001620250001 41）
		/	《流动资金借款 合同》（编号： HTWB44010001 62025000165）	2025.10.15- 2026.10.15	5,000		
中信银 行股份 有限公 司深圳 分行	时创意	《综合授信合 同》（编号： 2025 信银深授 字第 002756 号）	/	2025.11.06- 2027.03.10	30,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导 体	《最高额保证合同》（编 号：2025 深银龙华最保字 第 0062 号）； 《最高额保证合同》（编 号：2025 深银龙华最保字 第 0063 号）；
			《人民币流动资 金贷款合同》 （编号：2025 深 银龙华贷字第 0049 号）	2025.12.08- 2027.03.01	5,000		

授信/ 借款 银行	被授 信人/ 借款 人	授信合同编 号	借款合同编号	授信/借款 期限	授信/ 借款 额度	担保人/ 抵押物/ 质押物	担保合同
			《人民币流动资金借款合同》 (编号: 2025 深银龙华贷字第 0060 号)	2025.12.08- 2027.03.10	5,000		《最高额保证合同》(编 号: 2025 深银龙华最保字 第 0064 号)
			《人民币流动资金借款合同》 (编号: 2026 深银龙华贷字第 0002 号)	2026.01.13- 2027.02.17	5,000		
兴业银 行股份 有限公司深圳 分行	时创意	《额度授信合同》(编号: 兴银深梅林授信字(2026) 第 010 号); 分合同:《国内信用证在线 融资主协议》 (编号: GN202606300 002701M01)	/	2026.05.19- 2027.04.26	60,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导 体	《最高额保证合同》(编 号: 兴银梅林授信(保 证)字(2026)第 010A 号); 《最高额保证合同》(编 号: 兴银梅林授信(保 证)字(2026)第 010B 号); 《最高额保证合同》(编 号: 兴银梅林授信(保 证)字(2026)第 010C 号); 《最高额保证合同》(编 号: 兴银梅林授信(保 证)字(2026)第 010D 号)
			《进出口代付业 务协议》(编 号: 兴银深梅林 代付字(2026) 第 010 号)	2026.05.20- 2027.05.20	10,000		
			《进出口代付业 务协议》(编 号: 兴银深梅林 代付字(2026) 第 012 号)	2026.06.03- 2027.04.16	15,000		
			《进出口代付业 务协议》(编 号: 兴银深梅林 代付字(2026) 第 013 号)	2026.06.12- 2027.06.11	10,000		
		/	赤道原则项目借 款合同(编号: 兴银深沙井赤借 字(2023)第 ML68 号)、补 充协议(编号: 兴银深梅林补充 字(2024)第 ML68-1 号)	2023.03.21- 2033.03.21	43,500	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导 体、不动 产抵押	《保证合同》(编号: 兴 银深沙井保证字(2023) 第 ML68A 号); 《保证合同》(编号: 兴 银深沙井保证字(2023) 第 ML68B 号); 《保证合同》(编号: 兴 银深沙井保证字(2023) 第 ML68C 号); 《保证合同》(编号: 兴 银深沙井保证字(2023) 第 ML68D 号); 《抵押合同》(编号: 兴 银深梅林抵押字(2025) 第 ML68 号)
浙商银 行股份 有限公司深圳 分行	时创意	/	《借款合同》 (编号: (20929000)浙 商银借字 (2025)第 04874 号)	2025.12.19- 2026.12.18	4,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯	《最高额保证合同》(编 号: (20929000)浙商银 高保字(2025)第 00311 号)
中国建 设银行 股份有 限公司	时创意	/	《人民币流动资 金借款合同》 (合同编号: HTZ442008010L DZJ2026N00Q)	2026.03.12- 2027.06.11	5,000	倪黄忠、 李慕妃、 数钛芯、 徽忆半导	《本金最高额保证合同》 (编号: HTC442008010ZGDB2026 N01W); 《本金最高额保证合同》

授信/借款银行	被授信人/借款人	授信合同编号	借款合同编号	授信/借款期限	授信/借款额度	担保人/抵押物/质押物	担保合同
深圳市分行			《人民币流动资金借款合同》 (合同编号: HTZ442008010LDZJ2026N01N)	2026.06.25-2027.06.24	5,000	体	(编号: HTC442008010ZGDB2026N01X); 《本金最高额保证合同》 (编号: HTC442008010ZGDB2026N01R); 《本金最高额保证合同》 (编号: HTC442008010ZGDB2026N01T)
中国进出口银行深圳分行	时创意	/	《借款合同》 (编号: HET020200001720260500000006)	2026.05.25-2027.05.25	20,000	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、徽忆半导体	《保证合同》(编号: SCYZGEBZ-NHZ01); 《保证合同》(编号: SCYZGEBZ-LMF01); 《保证合同》(编号: SCYZGEBZ-STX01); 《保证合同》(编号: SCYZGEBZ-HY01)
			《借款合同》 (编号: HET020200001720260600000029)	2026.06.22-2027.06.29	10,000		
中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	时创意	《最高额授信合同》(编号: (SCY) 农银综授字(2025)第01号)	/	2025.12.17-2026.12.17	10,000	倪黄忠、李慕妃、数钛芯、徽忆半导体	《最高额保证合同》(编号: 811005202600000066)
			《中国农业银行股份有限公司国际贸易融资合同》(编号: 810601202600000002)	2026.01.28-2027.01.27	7,000		

4. 供应链融资合同

序号	债务人	债权人	合同名称	借款额度(万美元)	开始时间	到期时间
1	香港时创意	小米金融(香港)有限公司	《贷款协议》(编号: HKSCY-DKXY-202506)	3,000	2025.08.25	2026.08.24
2	香港时创意	Sunny Sight Finance Limited	《贷款协议》	1,500	2025.12.10	2026.12.10

注释: 经双方确认,《贷款协议》(编号: HKSCY-DKXY-202506)额度有效期延长至 2026 年 8 月 24 日;自 2026 年 3 月 26 日起,总贷款额度由 3,000 万美元调整为 5,000 万美元。

5. 重大建设工程施工合同

序号	合同名称	采购人	供应商	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	《深圳市时创意公司存储集成电路产业基地施工总承包工程施工合同》	时创意	中建五局华南建设有限公司	21,261.18	2022.08.02	工程竣工验收合格，尚在质保期内
2	《时创意集成电路大厦项目外立面工程施工合同》（编号：AJS-20240001）	时创意	深圳市汇诚装饰工程有限公司	3,219.15	2024.01.09	工程竣工验收合格，尚在质保期内
3	《深圳市时创意电子股份有限公司洁净厂房提升项目工程施工合同》（编号：AJS-20240015）及补充协议一	时创意	深圳市朗奥洁净科技股份有限公司	3,550.00	2024.05.22	工程竣工验收合格，尚在质保期内

（二）重大侵权之债

根据《审计报告（20260630）》、发行人出具的书面声明并经核查，补充事项期间，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及担保情况

根据《审计报告（20260630）》、发行人出具的书面声明并经核查，补充事项期间，除已在本补充法律意见书正文“九、关联交易及同业竞争”的相关内容中披露的关联交易外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及互相提供担保的情况。

（四）发行人金额较大的其他应收款、其他应付款

1. 其他应收款

根据《审计报告（20260630）》、发行人出具的书面声明并经核查，截至2026年6月30日，发行人其他应收款账面余额为5,373.61万元，主要构成如下：

项目	截至2026年6月30日		
	账面余额（万元）	坏账准备（万元）	账面价值（万元）
应收出口退税款	4,779.31	47.79	4,731.51
应收押金和保证金	395.97	1.98	393.99
应收代垫款	114.30	1.14	113.16
应收其他款项	84.03	1.22	82.81

项目	截至 2026 年 6 月 30 日		
	账面余额（万元）	坏账准备（万元）	账面价值（万元）
合并范围外关联方往来款	-	-	-
合计	5,373.61	52.14	5,321.47

注释：截至 2026 年 6 月 30 日，发行人其他应收款余额占当期流动资产比例为 0.78%，占比较小，主要为应收出口退税款、应收押金和保证金。

2. 其他应付款

根据《审计报告（20260630）》、发行人出具的书面声明并经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人其他应付款余额为 65,941.40 万元，主要构成如下：

项目（单位：万元）	截至 2026 年 6 月 30 日
关联方借款	32,245.63
供应链借款	8,622.67
保理借款	24,147.30
未付费用	920.81
押金保证金	5.00
合计	65,941.40

注释：截至 2026 年 6 月 30 日，发行人其他应付款余额主要为关联方借款及供应链借款，其中供应链借款系发行人为满足生产经营临时资金周转需求，依托供应链融资模式支付原材料采购款形成。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人重大资产变化及收购兼并。

经核查，补充事项期间，发行人不存在新的重大资产变化及收购兼并事项。

十三、发行人章程的制定与修改

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人章程的制定与修改。

经核查，补充事项期间，发行人的《公司章程》和《公司章程（草案）》未发生变化，上述章程的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人股东会、董事会议事规则及规范运作。

（一）发行人的组织机构

经核查，补充事项期间，发行人组织机构未发生变化。

（二）发行人的股东会、董事会、监事会议事规则

经核查，补充事项期间，发行人股东会、董事会议事规则未发生变化。

（三）发行人补充事项期间股东会、董事会、监事会及其规范运作

经核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人共召开2次股东会、1次董事会会议、发行人董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开了1次会议、1次会议。上述会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）股东会或董事会历次授权或重大决策

经核查，补充事项期间，发行人股东会或董事会历次授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人董事、监事、高级管理人员及其变化。

经核查，补充事项期间，发行人董事、高级管理人员未发生变化。

十六、发行人的税务

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的税务。

（一）发行人及其子公司执行的税种、税率

经核查，补充事项期间，发行人及其子公司执行的税种、税率未发生变化。

（二）发行人及其子公司享受的税收优惠

经核查，补充事项期间，发行人享受的税收优惠政策未发生变化。

（三）发行人补充事项期间新增主要政府补助

经核查，补充事项期间，发行人新增政府补助情况如下：

序号	主体名称	补助时间	项目	补助金额（元）
1	数钛芯	2026.04.30	宝安区商务局 AEO 高级认证企业奖励项目	500,000.00
2	时创意	2026.04.30	宝安区商务局 AEO 高级认证企业奖励项目	500,000.00
3	时创意	2026.05.29	2026 年外贸优质增长扶持计划（2025 年出口信用保险保费资助项目）（短期）	510,000.00

（四）发行人及其子公司补充事项期间依法纳税情况

经核查，补充事项期间，发行人及其子公司能够按期依法申报、依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人的环境保护和产品质量、技术等标准。

（一）发行人环境保护情况

经核查，补充事项期间，发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求；发行人已投产项目已履行必要环评手续；发行人不存在环保违法行为，不存在环保相关行政处罚，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在有关发行人环保的媒体负面报道。

（二）发行人产品质量和技术监督标准情况

经核查，补充事项期间，发行人的产品符合国家有关产品质量和技术监督的要求，发行人不存在因违反产品质量或技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

（三）发行人安全生产情况

经核查，补充事项期间，发行人及其子公司未发生过安全事故，不存在因违反有关安全生产的法律法规而受到行政处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人募集资金的运用。

（一）发行人募集资金投资项目

经核查，补充事项期间，发行人募集资金投资项目未发生变化。

（二）发行人募集资金投资项目取得的相关批准或备案

经核查，补充事项期间，发行人募集资金投资项目取得的相关批准或备案未发生变化。

（三）募集资金投资项目的合作及同业竞争情况

经核查，发行人募集资金投资项目为发行人独立负责具体实施，不存在与他人合作的情况，该等项目的实施不会导致同业竞争。

（四）募集资金专项存储

经核查，发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于制订〈深圳市时创意电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，该制度对发行人上市后募集资金专项存储、使用、管理与监督进行了详细的规定，募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户。

十九、发行人业务发展目标

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人业务发展目标。

经核查，补充事项期间，发行人业务发展目标未发生变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人诉讼、仲裁或行政处罚。

经核查，补充事项期间，发行人及其子公司、发行人的实际控制人、持股5%以上的主要股东、发行人的董事、高级管理人员、核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的对发行人经营及本次发行上市产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；发行人及其控股股东、实际控制人在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域不存在重大违法违规行为。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已审阅《招股说明书（申报稿）》，并对发行人引用的《律师工作报告》《法律意见书》及本补充法律意见书的相关内容进行了审阅和确认。

经核查，本所律师认为，《招股说明书（申报稿）》引用的《律师工作报告》《法律意见书》及本补充法律意见书的相关内容真实、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不会因此引致法律风险。

二十二、律师认为需要说明的其他问题

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了律师认为需要说明的其他问题。

（一）劳动用工规范性

1. 劳动用工情况

根据发行人提供的员工花名册、劳动合同等资料并经核查，报告期各期末

发行人及其子公司、分公司员工人数情况如下：

单位：人

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
员工人数	1025	961	924	856

注释：上表中报告期末员工人数不含非全日制用工人员。

截至本报告出具日，发行人能够按照《中华人民共和国劳动法》等规定，与在职员工签订劳动合同。

根据发行人的说明，经核查，报告期内公司及其境内分、子公司不存在劳务派遣用工的情形。

2. 发行人报告期内社会保险与住房公积金缴纳情况

(1) 社会保险缴纳与住房公积金缴纳情况

经核查，报告期各期末发行人及其境内分、子公司社会保险与住房公积金的缴纳情况如下：

单位：人

项目		2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
员工人数		1003	942	896	825
社会保险缴纳情况					
缴纳人数占比		98.40%	99.26%	99.33%	99.39%
未缴纳人数		16	7	6	5
未缴纳原因	当月新入职员工	16	7	5	3
	自愿放弃缴纳	-	-	1	2
住房公积金缴纳情况					
缴纳人数占比		97.31%	97.98%	96.99%	96.85%
未缴纳人数		27	19	27	26
未缴纳原因	当月新入职员工	15	7	5	4
	自愿放弃缴纳	12	12	22	22

注释 1：上表中员工人数均不包含境外员工和退休返聘人员。

注释 2：自愿放弃缴纳社保及公积金的在职员工已经出具关于放弃缴纳的声明函，确认放弃公司为其购买社会保险/住房公积金的权益，由此产生的一切风险及责任，由其本人承担。

（二）首发相关承诺

经核查，补充事项期间，发行人及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、发行人的董事、高级管理人员以及本次发行上市的中介机构出具的相关承诺及约束措施未发生变化。

二十三、结论意见

综上所述，本所律师对发行人本次发行上市发表总体性结论意见如下：

1. 补充事项期间，发行人仍符合《证券法》《公司法》《首发注册办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件所规定的公开发行股票并在创业板上市的主体资格和各项实质条件。

2. 发行人在《招股说明书（申报稿）》中引用的《法律意见书》和《律师工作报告》的内容适当，《招股说明书（申报稿）》不致因引用《法律意见书》和《律师工作报告》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 发行人本次发行尚需取得深交所的审核同意并经中国证监会履行发行注册程序；发行人股票于深交所上市尚待获得深交所的审核同意。

本补充法律意见书壹式陆份，伍份交发行人报深交所等相关部门和机构，壹份由本所留存备查，均由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

（本页以下无正文，下页为签字盖章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于深圳市时创意电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所
负责人：周琳凯

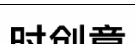
经办律师：邹棒
邹棒

经办律师：杨凯
杨凯

签署日期：2026年 9 月 19 日

附件一、发行人及其控股子公司的注册商标

1. 境内注册商标

序号	注册人	商标	注册号	国际分类	有效期限	取得方式	权利负担
1	时创意		第 20698660 号	9	2017.09.14-2027.09.13	原始取得	无
2	时创意		第 25789010 号	9	2018.11.07-2028.11.06	原始取得	无
3	时创意		第 50805946 号	9	2021.07.21-2031.07.20	原始取得	无
4	时创意		第 50805956 号	9	2021.07.28-2031.07.27	原始取得	无
5	时创意		第 50803148 号	9	2021.06.28-2031.06.27	原始取得	无
6	时创意		第 62344480 号	9	2023.06.14-2033.06.13	原始取得	无
7	时创意		第 62344480A 号	9	2022.08.14-2032.08.13	原始取得	无
8	时创意		第 77805618A 号	9	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无
9	时创意		第 77805665A 号	9	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无
10	时创意		第 77809083A 号	9	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无
11	时创意		第 77817699A 号	9	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无
12	时创意		第 77829780A 号	9	2024.12.07-2034.12.06	原始取得	无
13	时创意		第 77824297A 号	9、35	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无

序号	注册人	商标	注册号	国际分类	有效期限	取得方式	权利负担
14	时创意		第 77824318 号	9、35	2024.10.28-2034.10.27	原始取得	无
15	时创意	Hemory	第 78375766 号	9	2025.01.07-2035.01.06	原始取得	无
16	时创意	Hiiye	第 78382656A 号	9、35	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无
17	时创意	徽忆	第 78391989A 号	9	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无
18	时创意	徽忆存储	第 78398126A 号	9	2024.11.21-2034.11.20	原始取得	无
19	时创意	赛可驰	第 80272642 号	9	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	无
20	时创意	喜卡士	第 80268351 号	9	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	无
21	上海赛可驰		第 81414667 号	9、35	2025.04.14-2035.04.13	继受取得	无
22	上海赛可驰		第 81423972 号	9、35	2025.04.21-2035.04.20	继受取得	无
23	数钛芯		第 57252611 号	9	2022.03.07-2032.03.06	原始取得	无
24	数钛芯		第 57260532 号	9	2022.03.14-2032.03.13	原始取得	无

2.境外注册商标

序号	注册人	商标	注册号	注册国家/地区	注册类别	有效期至	取得方式	权利负担
1	时创意		02494416	中国台湾	9	2035.11.15	原始取得	无
2	时创意		DID2025041837	印度尼西亚	9	2035.05.14	原始取得	无
3	时创意		2547194	澳大利亚	9	2035.05.12	原始取得	无
4	时创意		2544086	澳大利亚	9	2035.04.30	原始取得	无
5	时创意		019182395	欧盟	9	2035.05.06	原始取得	无
6	时创意		02494395	中国台湾	9	2035.11.15	原始取得	无

序号	注册人	商标	注册号	注册国家/地区	注册类别	有效期至	取得方式	权利负担
7	时创意		DID2025039581	印度尼西亚	9	2035.05.07	原始取得	无
8	时创意		6997266	日本	9	2035.12.15	原始取得	无
9	时创意		7017445	日本	9	2036.02.18	原始取得	无
10	时创意		8,101,134	美国	9	2036.01.12（需 在第 5-6 年提交 使用声明维持）	原始取得	无
11	上海赛可驰		019133624	欧盟	9	2035.01.21	原始取得	无
12	上海赛可驰		019133655	欧盟	9	2035.01.21	原始取得	无
13	上海赛可驰	SIXSaikechi	8,085,987	美国	9	2035.12.29（需 在第 5-6 年提交 使用声明维持）	原始取得	无
14	上海赛可驰		1172602	俄罗斯	9	2035.01.17	原始取得	无

序号	注册人	商标	注册号	注册国家/地区	注册类别	有效期至	取得方式	权利负担
15	上海赛可驰		8,091,862	美国	9	2036.01.05（需 在第 5-6 年提交 使用声明维持）	原始取得	无
16	上海赛可驰		8,091,863	美国	9	2036.01.05（需 在第 5-6 年提交 使用声明维持）	原始取得	无
17	上海赛可驰		6951363	日本	9	2035.07.24	原始取得	无
18	上海赛可驰		6951364	日本	9	2035.07.24	原始取得	无

附件二、发行人及其控股子公司的专利权

1、境内专利清单

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
1	时创意	一种矩阵列式存储盘半自动检测设备及其检测方法	发明	2016101352384	2016.03.10	原始取得	无
2	时创意、深圳市众望国际科技有限公司	一种同基板兼容多种接口的多层叠加存储盘及其封装工艺	发明	2016108170974	2016.09.12	原始取得	无
3	时创意	一种半自动多卡晶圆一体测试机台	发明	2017102837546	2017.04.26	原始取得	无
4	时创意	一种半导体智能化管理系统	发明	2017106528217	2017.08.02	原始取得	无
5	时创意	一种应用于固态硬盘可靠性测试的大型高温测试设备	发明	2017110728945	2017.11.04	原始取得	无
6	时创意	一种采用真空吸盘固定 SD 卡的测试设备	发明	2018105675552	2018.06.05	原始取得	无
7	时创意	一种检测 Pair Page 的方法	发明	2019104863436	2019.06.05	原始取得	无
8	时创意	一种便于组装的移动固态硬盘结构	发明	2019106851429	2019.07.27	原始取得	无
9	时创意	一种可减少数据页分散的数据存储方法	发明	2019107750054	2019.08.21	原始取得	无
10	时创意	一种数据保存方法、装置、存储介质和数据存储设备	发明	2020102853517	2020.04.13	原始取得	无
11	时创意	存储芯片的数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质	发明	2020110604094	2020.09.30	原始取得	无
12	时创意	一种存储芯片序列码生成方法、装置、电子设备及存储介质	发明	2020114323649	2020.12.10	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
13	时创意	一种数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质	发明	2021113538239	2021.11.16	原始取得	无
14	时创意	一种芯片测试系统以及测试方法	发明	2022109542062	2022.08.10	原始取得	无
15	时创意	一种数据地址查询方法、装置、电子设备及可读存储介质	发明	2022113425127	2022.10.31	原始取得	无
16	时创意	一种基于多信道的数据读写处理方法、装置及相关设备	发明	2022113425165	2022.10.31	原始取得	无
17	时创意	检测闪存芯片编程干扰的方法、闪存芯片和存储设备	发明	2024119562555	2024.12.25	原始取得	无
18	时创意	固态硬盘及其运行方法	发明	2022117261658	2022.12.30	原始取得	无
19	时创意、深圳市众望国际科技有限公司	一种新型 TypeC 高速公头最少 Pin 数设计结构	实用新型	2016210485018	2016.09.12	原始取得	无
20	时创意	一种存储卡封装测试保护支架	实用新型	2017204476529	2017.04.26	原始取得	无
21	时创意	一种全自动内存卡矩阵移印装置	实用新型	2017204488371	2017.04.26	原始取得	无
22	时创意	一种集成电路 BGA 精准方向打标装置	实用新型	2017204488390	2017.04.26	原始取得	无
23	时创意	一种集成电路 BGA 快速测试机台	实用新型	2017204488403	2017.04.26	原始取得	无
24	时创意	一种水净化、污水循环零排放处理系统	实用新型	2017204490988	2017.04.26	原始取得	无
25	时创意	全自动化排板生产设备	实用新型	2017205040199	2017.05.09	原始取得	无
26	时创意	一种应用于固态硬盘可靠性测试的大型高温测试设备	实用新型	2017214561710	2017.11.04	原始取得	无
27	时创意	一种采用真空吸盘固定 SD 卡的测试设备	实用新型	2018208591944	2018.06.05	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
28	时创意	一种可自动装载电源的多开门周转老化测试设备	实用新型	201822240724X	2018.12.29	原始取得	无
29	时创意	一种高效 PCB 拼板结构	实用新型	2019210256116	2019.07.03	原始取得	无
30	时创意	一种便于组装的移动固态硬盘结构	实用新型	2019211941191	2019.07.27	原始取得	无
31	时创意	一种高兼容性移动固态硬盘外壳结构	实用新型	201921287182X	2019.08.09	原始取得	无
32	时创意	一种固态硬盘高温老化测试设备	实用新型	202020508858X	2020.04.09	原始取得	无
33	时创意	一种固态硬盘组件与固态硬盘	实用新型	2020229349007	2020.12.09	原始取得	无
34	时创意	一种固态硬盘组件与固态硬盘	实用新型	2021200184104	2021.01.04	原始取得	无
35	时创意	一种固态硬盘	实用新型	2021202703365	2021.01.29	原始取得	无
36	时创意	一种固态硬盘底壳、固态硬盘外壳与固态硬盘	实用新型	2021202830801	2021.02.01	原始取得	无
37	时创意	一种固态硬盘测试装置	实用新型	2021203878066	2021.02.22	原始取得	无
38	时创意	一种固态硬盘的测试装置与测试系统	实用新型	2021205455371	2021.03.16	原始取得	无
39	时创意	一种多层叠的 DIE 焊线结构及芯片	实用新型	2021223536199	2021.09.27	原始取得	无
40	时创意	一种芯片的分段式顶出装置	实用新型	2021225087955	2021.10.18	原始取得	无
41	时创意	一种 PCBA 板检测分选装置	实用新型	2021228578963	2021.11.19	原始取得	无
42	时创意	一种 Tray 盘、承载装置与测试系统	实用新型	2021231066918	2021.12.10	原始取得	无
43	时创意	一种自动化测试存储芯片的测试装置	实用新型	2022216539873	2022.06.29	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
44	时创意	一种批量半导体芯片的高温测试设备	实用新型	2022217928934	2022.07.12	原始取得	无
45	时创意	一种批量测试固态硬盘电流的测试装置及系统	实用新型	2022231129254	2022.11.22	原始取得	无
46	时创意	适配 SATA 协议的非嵌入式主系统存储卡与电子设备	实用新型	2022231631679	2022.11.28	原始取得	无
47	时创意	适配 NVMe 协议的非嵌入式主系统存储卡与电子设备	实用新型	202223167931X	2022.11.28	原始取得	无
48	时创意	适配 eMMC 协议非嵌入式主系统存储卡与电子设备	实用新型	2022231716338	2022.11.28	原始取得	无
49	时创意	适配 UFS 协议的非嵌入式主系统存储卡与电子设备	实用新型	2022231854164	2022.11.28	原始取得	无
50	时创意	非嵌入式主系统存储卡与电子设备	实用新型	2022231856507	2022.11.28	原始取得	无
51	时创意	一种 PCIe 信号传输装置及测试装置	实用新型	202223316149X	2022.12.09	原始取得	无
52	时创意	一种可移动磁盘	实用新型	2022233700796	2022.12.14	原始取得	无
53	时创意	封装基板及芯片	实用新型	2022233702575	2022.12.14	原始取得	无
54	时创意	芯片载板	实用新型	2022233703084	2022.12.14	原始取得	无
55	时创意	硅片研磨设备	实用新型	2022233720484	2022.12.14	原始取得	无
56	时创意	开卡转接板和开卡设备	实用新型	2022233721824	2022.12.14	原始取得	无
57	时创意	高温测试装置和检测系统	实用新型	2022233770178	2022.12.14	原始取得	无
58	时创意	固态硬盘	实用新型	2022233771895	2022.12.14	原始取得	无
59	时创意	通用型印刷电路板和芯片	实用新型	2022235001762	2022.12.26	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
60	时创意	存储卡	实用新型	202223531262X	2022.12.26	原始取得	无
61	时创意	储存卡的彩印治具和彩印装置	实用新型	2022235474978	2022.12.26	原始取得	无
62	时创意	印刷电路板、固态硬盘和印刷电路板制备装置	实用新型	2022235485953	2022.12.27	原始取得	无
63	时创意	老化装置	实用新型	2022235502022	2022.12.29	原始取得	无
64	时创意	IC 大板上盖印区域的检测治具	实用新型	2022235506837	2022.12.26	原始取得	无
65	时创意	印刷电路板和固态硬盘	实用新型	2022235529735	2022.12.27	原始取得	无
66	时创意	存储芯片和固态硬盘	实用新型	2022235536550	2022.12.29	原始取得	无
67	时创意	存储器和存储设备	实用新型	2022235934191	2022.12.30	原始取得	无
68	时创意	存储装置	实用新型	2022235943970	2022.12.29	原始取得	无
69	时创意	芯片测试治具	实用新型	2022235953135	2022.12.29	原始取得	无
70	时创意	存储模组和固态硬盘	实用新型	2022235995087	2022.12.27	原始取得	无
71	时创意	芯片测试治具	实用新型	2022236051909	2022.12.29	原始取得	无
72	时创意	固态硬盘组件和固态硬盘	实用新型	2022236052403	2022.12.29	原始取得	无
73	时创意	植球设备	实用新型	2022236052672	2022.12.29	原始取得	无
74	时创意	芯片测试系统和测试平台	实用新型	2022236057676	2022.12.30	原始取得	无
75	时创意	芯片测试系统和检测平台	实用新型	2022236057727	2022.12.30	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
76	时创意	烧录装置	实用新型	2022236077364	2022.12.30	原始取得	无
77	时创意	一种老化测试装置	实用新型	2022236077379	2022.12.30	原始取得	无
78	时创意	测试治具和芯片测试系统	实用新型	2022236079247	2022.12.30	原始取得	无
79	时创意	测试装置	实用新型	2022236079251	2022.12.30	原始取得	无
80	时创意	转用芯片	实用新型	2022236103778	2022.12.31	原始取得	无
81	时创意	信号测试装置和压力测试基板	实用新型	2022236103937	2022.12.31	原始取得	无
82	时创意	检测组件和检测装置	实用新型	2022236109929	2022.12.31	原始取得	无
83	时创意	测试装置和测试系统	实用新型	2022236109933	2022.12.31	原始取得	无
84	时创意	切割装置	实用新型	2022236114433	2022.12.31	原始取得	无
85	时创意	芯片分级测试装置和芯片分级测试系统	实用新型	2022236132022	2022.12.31	原始取得	无
86	时创意	开启设备和测试系统	实用新型	2022236132037	2022.12.31	原始取得	无
87	时创意	自动上下料的分选装置和分选机	实用新型	202223613208X	2022.12.31	原始取得	无
88	时创意	IC 载板和打标机	实用新型	2022236132107	2022.12.31	原始取得	无
89	时创意	二次封装 SSD 设备	实用新型	2022236132893	2022.12.30	原始取得	无
90	时创意	微型存储卡	实用新型	2022236132906	2022.12.30	原始取得	无
91	时创意	测试装置和测试大板老化装置的变温炉	实用新型	202223613575X	2022.12.31	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
92	时创意	测试装置和测试设备	实用新型	2022236135764	2022.12.31	原始取得	无
93	时创意	散热片组装治具	实用新型	2023208802081	2023.04.12	原始取得	无
94	时创意	测试装置	实用新型	2023208879308	2023.04.13	原始取得	无
95	时创意	DIE 测试装置	实用新型	2023208970782	2023.04.12	原始取得	无
96	时创意	固定组件和切割设备	实用新型	2023209103101	2023.04.13	原始取得	无
97	时创意	固态硬盘的测试设备和测试系统	实用新型	2023210105748	2023.04.27	原始取得	无
98	时创意	芯片载板	实用新型	2023210106632	2023.04.27	原始取得	无
99	时创意	测试座的开启设备和测试系统	实用新型	2023210106859	2023.04.27	原始取得	无
100	时创意	封装芯片和 U 盘	实用新型	2023210120856	2023.04.26	原始取得	无
101	时创意	测试装置	实用新型	2023210154208	2023.04.27	原始取得	无
102	时创意	一种电路板和固态硬盘	实用新型	2023210162609	2023.04.27	原始取得	无
103	时创意	通用型印刷电路板和通用型封装板	实用新型	2023210164642	2023.04.27	原始取得	无
104	时创意	读卡器和内存卡的读写设备	实用新型	2023210165062	2023.04.27	原始取得	无
105	时创意	存储芯片读取装置和存储设备	实用新型	2023210166953	2023.04.27	原始取得	无
106	时创意	一种测试电路板和测试装置	实用新型	202321437009X	2023.06.07	原始取得	无
107	时创意	PCB 板固定治具	实用新型	2023214764528	2023.06.09	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
108	时创意	存储芯片测试装置和测试系统	实用新型	2023214887157	2023.06.12	原始取得	无
109	时创意	打标设备	实用新型	2023214888126	2023.06.12	原始取得	无
110	时创意	镭射打标设备	实用新型	2023214922860	2023.06.12	原始取得	无
111	时创意	测试装置和测试系统	实用新型	2023214926931	2023.06.12	原始取得	无
112	时创意	开卡治具	实用新型	202321495289X	2023.06.12	原始取得	无
113	时创意	存储芯片的测试大板和测试装置	实用新型	2023215354041	2023.06.15	原始取得	无
114	时创意	测试治具和测试设备	实用新型	2023215385694	2023.06.15	原始取得	无
115	时创意	测试装置和测试设备	实用新型	2023216514300	2023.06.27	原始取得	无
116	时创意	测试设备和测试系统	实用新型	2023216524815	2023.06.27	原始取得	无
117	时创意	测试装置和测试系统	实用新型	2023216841321	2023.06.29	原始取得	无
118	时创意	转接板和主板	实用新型	2023217139618	2023.06.30	原始取得	无
119	时创意	存储器的插头	实用新型	2023217560503	2023.07.05	原始取得	无
120	时创意	存储器	实用新型	2023217564716	2023.07.05	原始取得	无
121	时创意	存储器的 PCB 板	实用新型	202321762998X	2023.07.05	原始取得	无
122	时创意	一种测试治具和测试系统	实用新型	2023218928902	2023.07.18	原始取得	无
123	时创意	PCB 板和电子设备	实用新型	2023218999058	2023.07.18	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
124	时创意	一种测试装置和测试设备	实用新型	202321900060X	2023.07.18	原始取得	无
125	时创意	测试转接板和测试系统	实用新型	2023219079518	2023.07.18	原始取得	无
126	时创意	芯片和存储设备	实用新型	2023220732948	2023.08.03	原始取得	无
127	时创意	示波器和测试设备	实用新型	2023221387589	2023.08.09	原始取得	无
128	时创意	一种测试电路板和测试装置	实用新型	2023221580177	2023.08.10	原始取得	无
129	时创意	封装模组和存储装置	实用新型	2023222504931	2023.08.21	原始取得	无
130	时创意	胶针机构和点胶装置	实用新型	2023224407688	2023.09.06	原始取得	无
131	时创意	测试装置和测试设备	实用新型	2023224639469	2023.09.11	原始取得	无
132	时创意	固态硬盘	实用新型	2023225094549	2023.09.15	原始取得	无
133	时创意	温控装置和测试系统	实用新型	2023227307145	2023.10.11	原始取得	无
134	时创意	PCB 拼板的切割装置	实用新型	2023229239388	2023.10.27	原始取得	无
135	时创意	移动存储器	实用新型	2023229418354	2023.10.31	原始取得	无
136	时创意	一种测试设备	实用新型	2023230928057	2023.11.15	原始取得	无
137	时创意	印刷线路板和存储设备	实用新型	2023232143323	2023.11.27	原始取得	无
138	时创意	存储芯片的测试装置	实用新型	2023232556792	2023.11.29	原始取得	无
139	时创意	一种测试电路板、测试装置和测试设备	实用新型	2023232872198	2023.12.01	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
140	时创意	一种测试装置和测试设备	实用新型	2023233027175	2023.12.01	原始取得	无
141	时创意	晶圆测试装置和测试系统	实用新型	2023233204644	2023.12.06	原始取得	无
142	时创意	印刷电路板和存储器	实用新型	2023233629875	2023.12.07	原始取得	无
143	时创意	芯片	实用新型	2023233941918	2023.12.12	原始取得	无
144	时创意	测试机台	实用新型	2023234369485	2023.12.15	原始取得	无
145	时创意	一种转接板和测试设备	实用新型	2023234397837	2023.12.15	原始取得	无
146	时创意	存储设备和 U 盘	实用新型	202323538806X	2023.12.22	原始取得	无
147	时创意	锡炉装置	实用新型	2024200499131	2024.01.09	原始取得	无
148	时创意	EMMC 测试装置	实用新型	2024200622884	2024.01.09	原始取得	无
149	时创意	测试治具和测试系统	实用新型	2024204014375	2024.03.01	原始取得	无
150	时创意	Nand 测试结构、测试组件和测试装置	实用新型	2024206296431	2024.03.28	原始取得	无
151	时创意	测试机柜	实用新型	2024208744841	2024.04.25	原始取得	无
152	时创意	拾取装置	实用新型	202420899739X	2024.04.27	原始取得	无
153	时创意	一种测试装置和测试设备	实用新型	2024215801660	2024.07.04	原始取得	无
154	时创意	一种模具拆装治具	实用新型	2024215810852	2024.07.05	原始取得	无
155	时创意	一种芯片测试设备	实用新型	2024215916768	2024.07.05	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
156	时创意	一种固态硬盘测试装置	实用新型	2024222491156	2024.09.13	原始取得	无
157	时创意	一种插接辅助装置	实用新型	2024222492040	2024.09.13	原始取得	无
158	时创意	开合盖机构和测试设备	实用新型	2024224436261	2024.10.10	原始取得	无
159	时创意	按压装置和电路板放置架	实用新型	2024224485874	2024.10.10	原始取得	无
160	时创意	芯片测试板、芯片测试装置和测试系统	实用新型	2024224833497	2024.10.14	原始取得	无
161	时创意	激光打标组件和激光打标系统	实用新型	2024225248804	2024.10.18	原始取得	无
162	时创意	转接板和测试装置	实用新型	202422777497X	2024.11.14	原始取得	无
163	时创意	存储芯片和电子设备	实用新型	2024228332261	2024.11.19	原始取得	无
164	时创意	测试板和测试装置	实用新型	2024229262088	2024.11.27	原始取得	无
165	时创意	一种测试装置和测试设备	实用新型	2024231554258	2024.12.19	原始取得	无
166	时创意	转接装置和测试系统	实用新型	2024231620230	2024.12.19	原始取得	无
167	时创意	通用闪存存储电路和通用闪存存储器	实用新型	202423224127X	2024.12.24	原始取得	无
168	时创意	校准装置和校准设备	实用新型	2024230256139	2024.12.06	原始取得	无
169	时创意	驱动电路和测试装置	实用新型	2024233170661	2024.12.31	原始取得	无
170	时创意	测试装置和测试系统	实用新型	2024233181083	2024.12.31	原始取得	无
171	时创意	组装装置和组装设备	实用新型	2024233189329	2024.12.31	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
172	时创意	电路板和存储模组产品	实用新型	2024233212236	2024.12.31	原始取得	无
173	时创意	限位组件和芯片测试装置	实用新型	2024233217174	2024.12.31	原始取得	无
174	时创意	贴标装置	实用新型	2025204119704	2025.03.10	原始取得	无
175	时创意	测试治具和测试系统	实用新型	2025204251568	2025.03.10	原始取得	无
176	时创意	测试治具和测试系统	实用新型	2025204256487	2025.03.10	原始取得	无
177	时创意	移动固态硬盘	外观设计	2019304319895	2019.08.09	原始取得	无
178	时创意	固态硬盘	外观设计	2021303054540	2021.05.21	原始取得	无
179	时创意	移动固态硬盘	外观设计	2023302000650	2023.04.13	原始取得	无
180	时创意	内存条	外观设计	2023302000792	2023.04.13	原始取得	无
181	时创意	固态硬盘	外观设计	202330200099X	2023.04.13	原始取得	无
182	时创意	存储器	外观设计	2023304194190	2023.07.05	原始取得	无
183	时创意	移动固态硬盘	外观设计	202330644756X	2023.10.07	原始取得	无
184	时创意	移动固态硬盘	外观设计	2023307074684	2023.10.31	原始取得	无
185	时创意	移动固态硬盘	外观设计	2024302615490	2024.05.07	原始取得	无
186	时创意	移动固态硬盘组件	外观设计	2024302615503	2024.05.07	原始取得	无
187	时创意	移动固态硬盘	外观设计	2024307271066	2024.11.18	原始取得	无

序号	专利权人	名称	类型	专利号	申请日期	取得方式	权利负担
188	时创意	散热片	外观设计	2024307272783	2024.11.18	原始取得	无
189	时创意	数字示波器	外观设计	2024308400971	2024.12.31	原始取得	无
190	时创意	U 盘	外观设计	2025300253413	2025.01.15	原始取得	无
191	时创意	基于智能手表的内存测试治具	外观设计	202530241402X	2025.04.29	原始取得	无
192	时创意	固态硬盘散热片	外观设计	2025302760624	2025.05.16	原始取得	无
193	时创意	移动硬盘（SSP25Pro-V PSSD）	外观设计	2025303736088	2025.06.27	原始取得	无
194	数钛芯	一种兼容多种晶元空间布局的集成电路 BGA 载板	实用新型	2017204482661	2017.04.26	继受取得	无

2、境外专利清单

序号	专利权人	名称	类型	注册地区/国家	公告号/专利号	申请日期	取得方式	权利负担
1	时创意有限、 慧荣科技股份 有限公司	固態硬碟之批量自動測試方法與批量自動測 試裝置	发明	中国台湾	I670722	2018.06.12	原始取得	无
2	时创意有限、 慧荣科技股份 有限公司	Batch automatic test method for solid state disks and batch automatic test device for solid state disks	发明	美国	US 10,768,852 B2	2019.02.28	原始取得	无

附件三、发行人及其控股子公司的计算机软件著作权

序号	著作权人	软件著作权名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	权利负担
1	时创意	PCB 回流焊点三维重建增强处理插件软件 V1.0	2018SR1082689	2018.05.10	2018.05.10	原始取得	无
2	时创意	投影式锡膏轮廓图像测量增强处理软件 V1.0	2018SR1083210	2018.10.23	2018.10.23	原始取得	无
3	时创意	BGA 一致性统计与标记软件 V1.0	2018SR1082698	2018.04.25	2018.04.25	原始取得	无
4	时创意	光学检测摄像头云台精确定位控制软件 V1.0	2018SR1082670	2018.07.25	2018.07.25	原始取得	无
5	时创意	干涉式锡膏印刷表面平整度快检处理软件 V1.0	2018SR1082680	2018.06.18	2018.06.18	原始取得	无
6	时创意	激光切割机切割路径优化模块软件 V1.0	2019SR0014844	2018.08.06	2018.08.06	原始取得	无
7	时创意	自动化测试存储芯片软件系统 V1.0	2022SR1398677	2022.07.06	未发表	原始取得	无
8	时创意	自动化测试存储芯片软件系统[简称：RD202216]V1.0	2022SR1398678	2022.07.06	未发表	原始取得	无
9	时创意	SSD ToolBox 磁盘测试工具 V1.0	2025SR0291821	2022.08.09	未发表	原始取得	无
10	时创意	一种内存 SPD 信息自动化烧录装置软件系统 V1.0	2025SR0133386	2022.06.28	未发表	原始取得	无
11	时创意	一种内存 SPD 信息自动化烧录装置软件系统 V1.0	2025SR0126749	2022.06.28	未发表	原始取得	无
12	时创意	一种内存 SPD 信息烧录控制系统 V1.0	2025SR1689709	2025.05.20	未发表	原始取得	无

附件四、发行人及其控股子公司的作品著作权

序号	著作权人	作品著作权名称	登记号	创作完成日期	首次发表日期	取得方式	权利负担
1	时创意	SCY 视觉识别形象基础手册	国作登字-2026-L-00145723	2026.03.10	未发表	原始取得	无
2	时创意	SCY 视觉识别形象应用手册	国作登字-2026-L-00148841	2026.03.10	未发表	原始取得	无